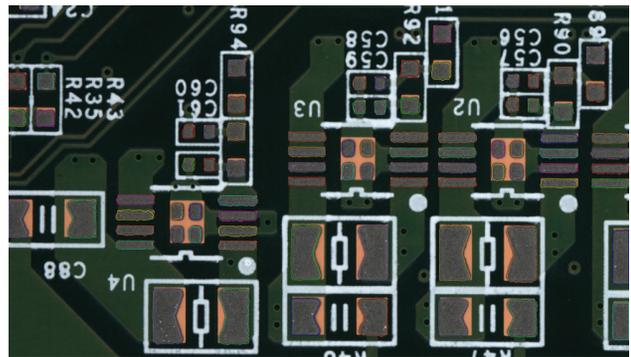
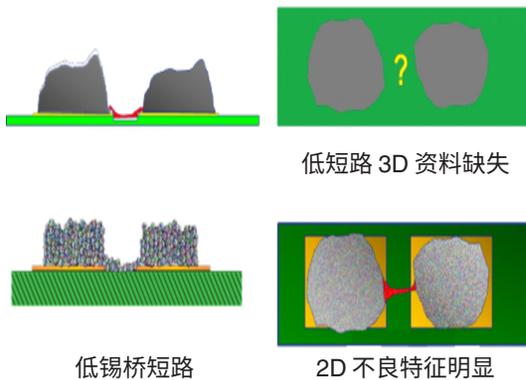


高精度 3D SPI: TU560



- ◆ 12M/25M 高帧率 CXP 工业相机
- ◆ 应用于 MINI LED 产品高精度、高速度检测
- ◆ 双向可编程数字光栅
- ◆ 5um、7um 高解析度光学
- ◆ 可检测 20um~400um 锡膏厚度
- ◆ 量测精度 1um
- ◆ 核心 GPU 算法
- ◆ 实时 SPC 信息显示, 可生成多种统计报表

彩色图像显示所见即所得。便于不良判定,减少人为漏失。同时2D辅助分割,能体现出低高度锡膏特征,锡膏识别更准确。有助于提升不良检出率。



规格参数

机型	型号	TU560 配置 1	TU560 配置 2
功能	检测项目	漏印、多锡、少锡、连锡、拉尖、形状不良、偏移	
性能	相机	1200 万像素高速相机 (4096 x 3072 像素)	2500 万像素高速相机 (5120 x 5120 像素)
	光学配置	5um; FOV:20mm x 15mm	7um;FOV: 36mm x 36mm
	光源	双 DLP 光源 (光栅相移技术) 和 红绿蓝 (RGB) 光源	
	扫描方式	Stop&Go(走停式)	
	检测速度	3FOV/sec	
	高度精度 (校正模块)	1um (使用标准校验块)	
	体积重复精度	<1% (标准校验块, 3Sigma)	
	最大板弯补偿值	±2mm	
	检测能力 Gage R&R	<10% at 6σ(±50% tolerance、5μm 解析度)	
	最小可测锡点间距	50um	
	最小可测锡点尺寸	50um x 50um	
	最大可测锡点高度	400μm	
平台	运动机构	丝杠导轨	
	解析精度	1μm	
	移动速度	800mm/sec	
输送系统	最小电路板可测尺寸	50 x 50mm	
	最大电路板可测尺寸	510mm x 460mm	
	电路板可测厚度	0.5mm~6mm	
	最大板重限制	5kg	
	轨道宽度调整	自动调宽、手动调宽	
	电路板输送 / 固定	皮带输送 / 气压夹板固定	
	输送方向	从左到右、从右到左	
	轨道高度	900±40mm	
	通讯接口	标准 SMEMA	
	零件高度限制	上端: 30mm 底端: 55mm 侧边: 3mm~5mm	
外观和重量	外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	1060x1290x1620 (三色灯 340mm)	
	系统重量	650KG	
电气规格	电源	220V 单相, 50~60Hz, 2.5kVA	
	气压	5Kg/cm ²	
软件	支持的输入格式	支持 Gerber Format(274X) 格式, ODB++	
	统计管理工具	Histogram,X-bar&R-Chart,X-bar&S-Chart,Cp&Cpk,%Gage R&R,SPI Daily/Weekly/Monthly Reports, 实时 SPC & Multiple Display	
	操作系统	Windows 10 64Bit	
环境	温度	10~40°C	
	湿度	10~85% RH 无凝霜	
其它	选配功能	离线编程、外置条码枪、UPS 不间断电源、SPC 数据中心、贴片机 badmark 共享	

苏州图锐智能科技有限公司

Suzhou Truteck Intelligence Technology Co.,Ltd

电话 :0512-62625966

传真 :0512-62860508

邮箱: sales@truteck.com

网址 :www.truteck.com

公司地址: 江苏省苏州市工业园区奇业路 68 号

华南办事处地址: 深圳市宝安区福海街道华丰智谷福海科技产业园 B 栋 105



微信公众号



公司官网

2022.11